471-5LL

PCB 及電子零件灌注膠

UL File No. E100866、E333984、E87039

特　　點

- 低稠度，作業時間長。低放熱，低收縮，散熱性良好。
- 收縮小，不會拉壞細線路及 Core，對電感（L 值）影響極小。

物　　性

		主劑(B 劑)		硬化劑(A 劑)
黏　　度	@25°C	12,500-25,000cps		20-50cps
比　　重	@25°C	1.67		0.96
閃 火 點	(ASTM D93)	＞94°C		＞90°C
重量混合比	(主劑：硬化劑)	100	:	15
體積混合比	(主劑：硬化劑)	100	:	25

混合後黏度	@25°C (ASTM D2196)	2,000-3,000 cps
可操作時間	@25°C	150 分鐘
膠化時間	@25°C、150 克	6-10 小時
硬化條件	(基本硬化)	25°C x 24 小時 or 80°C x 4 小時
抗張強度	(ASTM D229)	5,700 psi (39.3 MPa)
斷裂延伸率	(ASTM D229)	5 %
彎曲強度	(ASTM D790)	17,000 psi (117 MPa)
硬　　度		Shore D 80 (完全硬化)
玻璃轉化溫度(Tg)		50 °C
耐　　燃　　性	UL 94、2.9mm 厚	V–0
熱膨脹係數	Tg 前	4 x 10^{-5} IN/IN/°C
	Tg 後	1.95 x 10^{-4} IN/IN/°C
熱傳導係數		0.5 W/mK (0.29 BTU/Hr/FT^2/FT/°F)
吸　　水　　率	@25°C、浸水 168 小時	0.4%
重量損失率	@135°C、浸水 168 小時	0.5%
絕緣強度	(ASTM D149)、125mils	
	剛硬化後	510 Volts/mil (20 kV/mm)
	浸水 24 小時	480 Volts/mil (19 kV/mm)
絕緣常數	@25°C、1KHz	4.2
消散因素	@25°C、1KHz	0.03
體積電阻	@25°C (ASTM D257)	1.5 x 10^{14} ohm-cm

※備註：樣品放置25°C x 7天後可完全硬化。　※主劑(B劑)於使用前需攪拌均勻。

傑地有限公司

UL MIL 絕緣材料・粘膠・溫控器材

台北TEL:886-2-26008672 台中TEL:886-4-25685848
東莞TEL:86-769-88188707 上海TEL:86-21-58356975
Home Page: www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net